

TSMC investit 5 milliards de dollars dans une nouvelle usine

TSMC (*Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp.*) va s'équiper d'un centre de recherche chargé de mettre au point **des techniques de gravure en 32 nano-mètres (nm), 22 nm et 15 nm**. La compagnie fait ainsi taire les critiques qui ont fusé lorsqu'elle a intercalé le 55 nm dans ses processus de fabrication, une étape entre le 65 nm et le 45 nm que nombre de ses clients trouvaient inutile.

Deux nouvelles tranches de la Fab 12 serviront à la fois à **étendre la capacité actuelle de production de l'usine**, mais aussi à **créer un nouveau centre de recherche**. Les résultats seront alors appliqués à la Fab 14. Les Fab 12 et Fab 14 sont les deux usines de la firme produisant des *wafers* de 300 mm.

Ces travaux de construction et de recherche couteront **un total de cinq milliards de dollars**. Cet investissement permettra également de créer **trois mille nouveaux emplois**. La compagnie n'a pas fourni de *planning* de sortie précis, mais si elle maintient son rythme actuel, la finesse de gravure de 32 nm pourrait être atteinte en 2009, les 22 nm en 2011 et les 15 nm en 2013.